

<<电子产品装配与调试>>

图书基本信息

书名：<<电子产品装配与调试>>

13位ISBN编号：9787111396901

10位ISBN编号：7111396901

出版时间：2012-10

出版时间：机械工业出版社

作者：戴树春

页数：137

字数：223000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品装配与调试>>

内容概要

《电子产品装配与调试(全国高等职业教育规划教材)》(作者戴树春)是遵循高职高专学生的认知和职业成长规律而编写的基本技能型教材。

《电子产品装配与调试(全国高等职业教育规划教材)》共分为4个项目,项目1介绍常用电子元器件的识别与检测,项目2介绍电子元器件的焊接工艺,项目3介绍整机的装配与调试,项目4介绍电子产品的检验与包装。

本书选取典型的小型电子产品为载体,电路从简单到复杂,逐步涉及多种电子操作工艺,使学生获得电子产品装配与调试全过程的知识和技能。

本书可作为高职高专电子信息类、机电类等专业的教材,也可作为相关专业的电子技能实训教材。

<<电子产品装配与调试>>

书籍目录

出版说明

前言

项目1 常用电子元件的识别与检测

任务1.1 电阻的识别与检测

1.1.1 电阻及其特性

1.1.2 电阻的检测方法

1.1.3 电阻的使用常识

1.1.4 特种电阻

1.1.5 任务实施

任务1.2 电容的识别与检测

1.2.1 电容及其特性

1.2.2 电容的检测方法

1.2.3 任务实施

任务1.3 电感的识别与检测

1.3.1 电感及其特性

1.3.2 电感的检测方法

1.3.3 任务实施

任务1.4 常用半导体器件的识别与检测

1.4.1 二极管及其特性

1.4.2 二极管的检测方法

1.4.3 晶体管及其特性

1.4.4 晶体管的检测方法

1.4.5 任务实施

任务1.5 常用集成电路的识别与检测

1.5.1 集成电路的型号和分类

1.5.2 外形结构和引脚排列

1.5.3 集成电路使用注意事项

1.5.4 常用集成电路芯片介绍

1.5.5 集成电路的检测方法

1.5.6 任务实施

项目2 电子元件的焊接工艺

任务2.1 焊接基础知识

2.1.1 焊接基本原理

2.1.2 手工焊接工具和材料

2.1.3 任务实施

任务2.2 手工焊接操作与拆焊

2.2.1 手工焊接的基本操作

2.2.2 手工焊接的流程和方法

2.2.3 导线和接线端子的焊接

2.2.4 焊接质量的检查与分析

2.2.5 任务实施

任务2.3 拆焊

2.3.1 拆焊方法

2.3.2 拆焊时的注意事项

2.3.3 拆焊后重新焊接时应注意的问题

<<电子产品装配与调试>>

2.3.4 任务实施

任务2.4 现代焊接技术

2.4.1 浸焊

2.4.2 波峰焊

2.4.3 再流焊

2.4.4 无铅焊接

2.4.5 任务实施

项目3 整机的装配与调试

任务3.1 认识电子工艺文件

3.1.1 电子工艺文件的种类

3.1.2 编制电子工艺文件的方法

3.1.3 任务实施

任务3.2 元器件引线的预处理与插装

3.2.1 元器件引脚的预处理

3.2.2 元器件的插装

3.2.3 特殊元器件的插装

3.2.4 任务实施

任务3.3 导线的加工

3.3.1 绝缘导线的加工

3.3.2 屏蔽导线端头的加工

3.3.3 同轴电缆端头的加工方法

3.3.4 任务实施

任务3.4 电子节能荧光灯的装配与检测

3.4.1 任务描述

3.4.2 任务相关知识

3.4.3 任务实施

3.4.4 任务总结

任务3.5 数字万用表的装配与调试

3.5.1 任务描述

3.5.2 任务相关知识

3.5.3 任务实施

3.5.4 任务总结

任务3.6 闪烁灯的制作与调试

3.6.1 任务描述

3.6.2 任务相关知识

3.6.3 任务实施

3.6.4 任务总结

任务3.7 多路可调直流稳压电源的设计与制作

3.7.1 任务描述

3.7.2 任务相关知识

3.7.3 任务实施

3.7.4 任务总结

任务3.8 高频无线短距离电力传输系统的设计与制作

3.8.1 任务描述

3.8.2 任务相关知识

3.8.3 任务实施

3.8.4 任务总结

<<电子产品装配与调试>>

项目4 电子产品的检验与包装

任务4.1 电子产品的检验工艺

4.1.1 电子产品的检验项目

4.1.2 电子产品的检验顺序

4.1.3 电子产品的样品试验

4.1.4 任务实施

任务4.2 电子产品的包装

4.2.1 电子产品的包装种类

4.2.2 电子产品包装前的准备

4.2.3 电子产品的包装原则

4.2.4 电子产品的包装材料

4.2.5 电子产品包装的防伪标志

4.2.6 电子产品包装的设计要求

4.2.7 任务实施

参考文献

<<电子产品装配与调试>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>